

RE01B グループ

Bluetooth 専用クロック周波数の調整手順

要旨

本資料では、RE01B Bluetooth® 5.0 (Core Specification v5.0) RF トランシーバ専用クロック周波数の調整手順について説明します。

対象デバイス

RE01B グループ

【注】 本資料に掲載している内容は参考例であり、システムでの信号品質を保証するものではありません。実際のシステムに組み込む場合は、システム全体で十分検討評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。

目次

1.	はじめに	3
1.1	関連ドキュメント	3
2.	Bluetooth 専用クロック発振器	3
3.	周波数調整手順	4
3.1	必要ソフトウェア	4
3.2	測定セットアップ	4
3.2.1	ANT 出力周波数を有線接続で観測する場合	4
3.2.2	ANT 出力周波数を無線接続で観測する場合	5
3.3	“CLVALTune.exe”の使い方	6
3.3.1	ANT 出力周波数を観測する場合	6
3.4	Bluetooth 専用クロック周波数の調整手順	7
4.	RF トランシーバ用水晶振動子	8
5.	参考	9
5.1	周波数調整例	9
	改訂記録	11

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ルネサス エレクトロニクス株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

1. はじめに

本資料では、RE01B グループの Bluetooth 専用クロック (32 MHz) の周波数を最適にチューニングするまでの一連の手順について記載します。

1.1 関連ドキュメント

本アプリケーションノートに関連するドキュメントを以下に示します。併せて参照して下さい。

- RE01B ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0903)
- RE01B グループ ハードウェアデザインガイド (R01AN5471)
- RE01B グループ Bluetooth Low Energy サンプルコード (using CMSIS Driver Package) (R01AN5606)

2. Bluetooth 専用クロック発振器

図 2-1 に Bluetooth 専用クロック発振器を示します。クロック発振器には、2つの周波数調整用容量(CL)が内蔵されており、それぞれ XTAL1_RF 端子および XTAL2_RF 端子に内部接続されています。CL 容量値は 2-15 pF (typical 条件) の範囲で調整可能です。適切な容量設定 (CLVAL) を選択することで、発振周波数誤差を最小化することができます。

水晶振動子と RE01B 間を接続する配線パターン容量、部品配置パッドの寄生容量 (Cp1, Cp2) は周波数の変動要因となります。基板レイアウトや水晶振動子によって最適な容量設定が異なります。

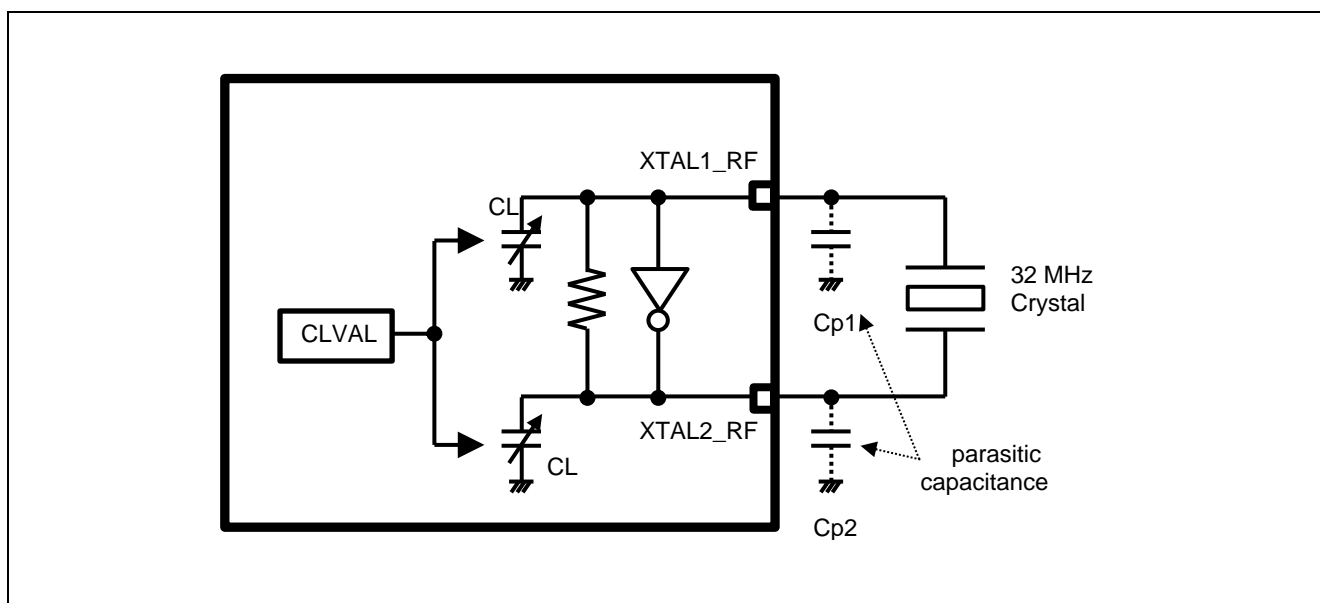


図 2-1 Bluetooth 専用クロック発振器

3. 周波数調整手順

本章では Bluetooth 専用クロック周波数の調整手順について説明します。

3.1 必要ソフトウェア

Bluetooth 専用クロック周波数調整に必要なソフトウェアは下記です。

- UART-HCI モードのファームウェア
「RE01B グループ Bluetooth Low Energy サンプルコード (using CMSIS Driver Package)」を Web からダウンロードし、測定対象の環境で動作する UART-HCI モードのファームウェアを作成する必要があります。
- CLVALTune.exe
本ソフトウェアは「RE01B 向け Bluetooth Low Energy プロトコルスタック基本パッケージ」に含まれます。

3.2 測定セットアップ

3.2.1 ANT 出力周波数を有線接続で観測する場合

図 3-1 のセットアップでは ANT 端子から 2440 MHz の無変調信号を出力し、同軸ケーブル接続にて信号周波数を観測します。高精度の周波数測定を行うため、スペクトラムアナライザは周波数カウンタモードに設定して下さい。

- 必要環境
 - RE01B 実装基板
 - 測定器
 - 周波数カウンタ機能搭載スペクトラムアナライザ (3GHz 以上)
 - 同軸ケーブル
 - 評価用 PC
 - USB to UART ケーブル

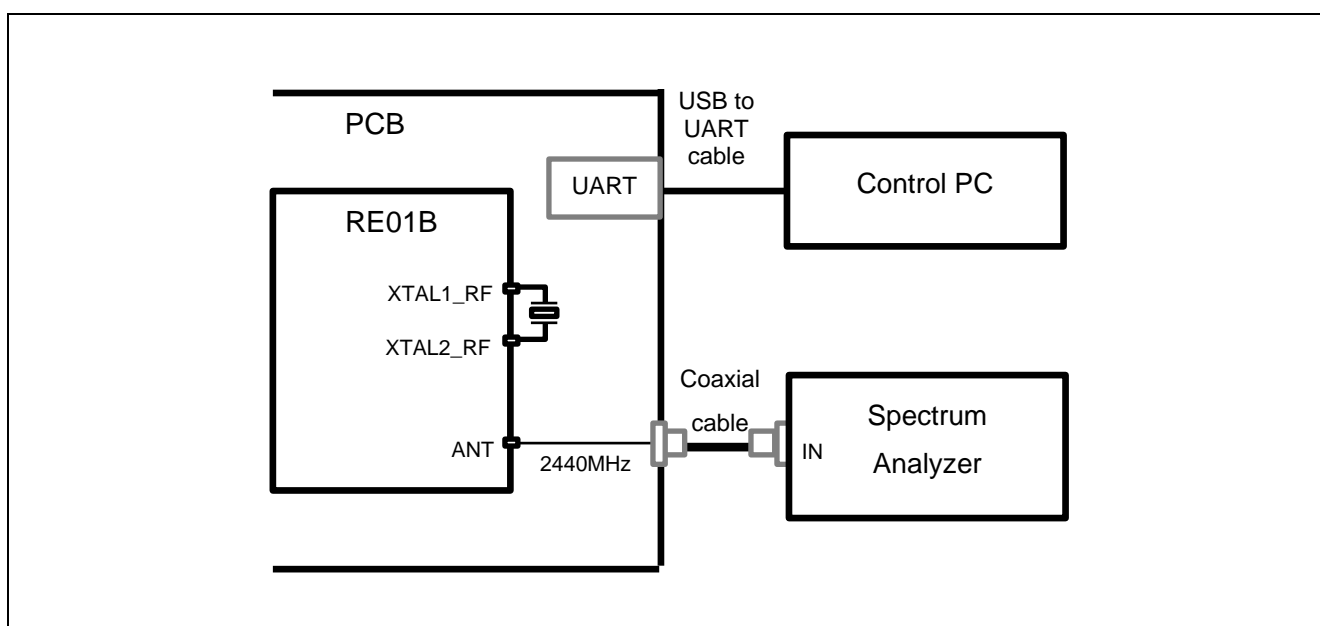


図 3-1 ANT 端子による周波数観測セットアップ(有線接続)

3.2.2 ANT 出力周波数を無線接続で観測する場合

図 3-2 のセットアップでは ANT 端子から 2440 MHz の無変調信号を出力し、無線アンテナ接続にて信号周波数を観測します。高精度の周波数測定を行うため、スペクトラムアナライザは周波数カウンタモードに設定して下さい。無線接続セットアップを選択した場合は、2.4 GHz 帯の他信号が入らないよう電波状況の良い環境で行って下さい。また測定器への入力振幅を一定レベル以上とするため RE01B に接続されたアンテナと測定器に接続されたアンテナを近づけて下さい。

無線接続での測定が不安定な場合、ANT 配線パターンに同軸ケーブルを直接半田実装し、3.2.1 の有線接続で測定して下さい。

- 必要環境
 - RE01B 実装基板
 - 測定器
 - 周波数カウンタ機能搭載スペクトラムアナライザ(3GHz 以上)
 - Bluetooth 対応無線アンテナ
 - 評価用 PC
 - USB to UART ケーブル

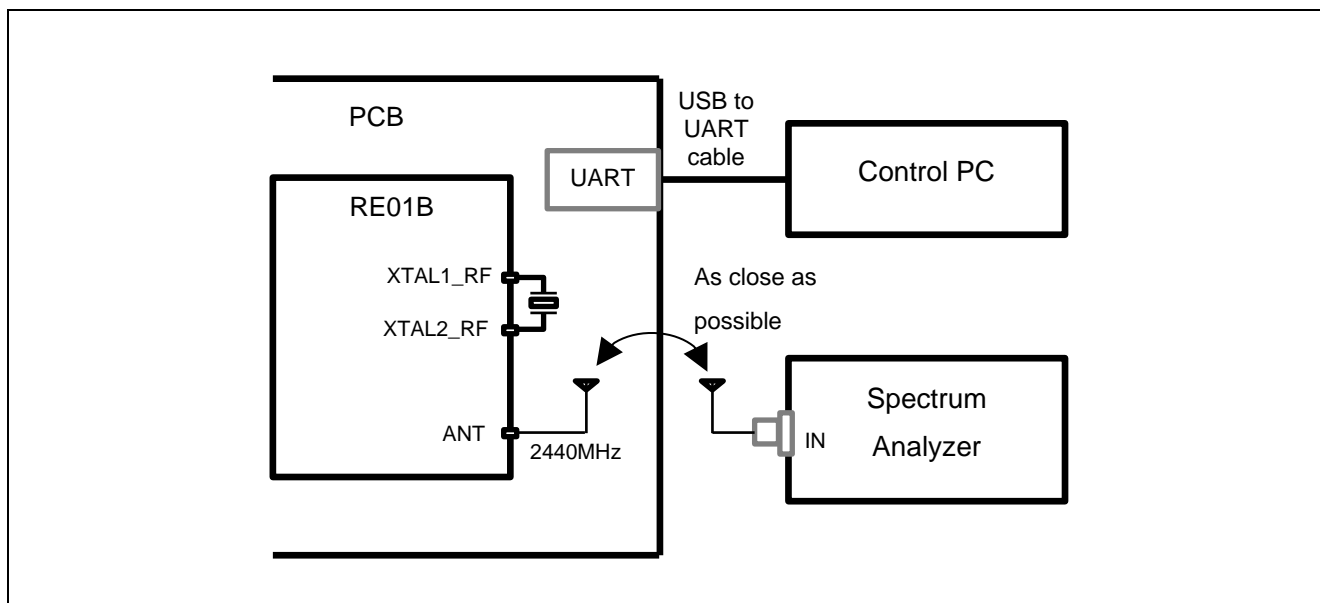


図 3-2 ANT 端子による周波数観測セットアップ(無線接続)

3.3 “CLVALTune.exe”の使い方

“CLVALTune.exe”は周波数調整の専用ソフトウェアです。本ソフトウェアを使用するには調整対象の環境で動作する UART-HCI モードのファームウェアが必要となります。

【注】 調整対象の環境で UART 端子を引き出せない場合は本ソフトウェアを使用できません。その場合は 16 パターンの CLVAL 調整用組み込みファームウェアを都度書き換えて周波数測定を行う必要があります。

3.3.1 ANT 出力周波数を観測する場合

ANT 端子からの 2440 MHz 無変調信号を観測する場合のプログラム設定を図 3-3 に示します。本設定は有線/無線接続で共通です。

COM port : PC 環境に依存

Baudrate : UART-HCI モードファームウェアに依存 (デフォルト値: 115200)

CLVAL : 周波数調整容量設定値。0~15 から任意値を選択 (デフォルト値: 5)

CLKOUT_RF : “No output”を選択

Continuous Wave Tx : “19ch (2440 MHz)”を選択

【注】 RE01B は、“CLKOUT_RF”機能をサポートしていません。

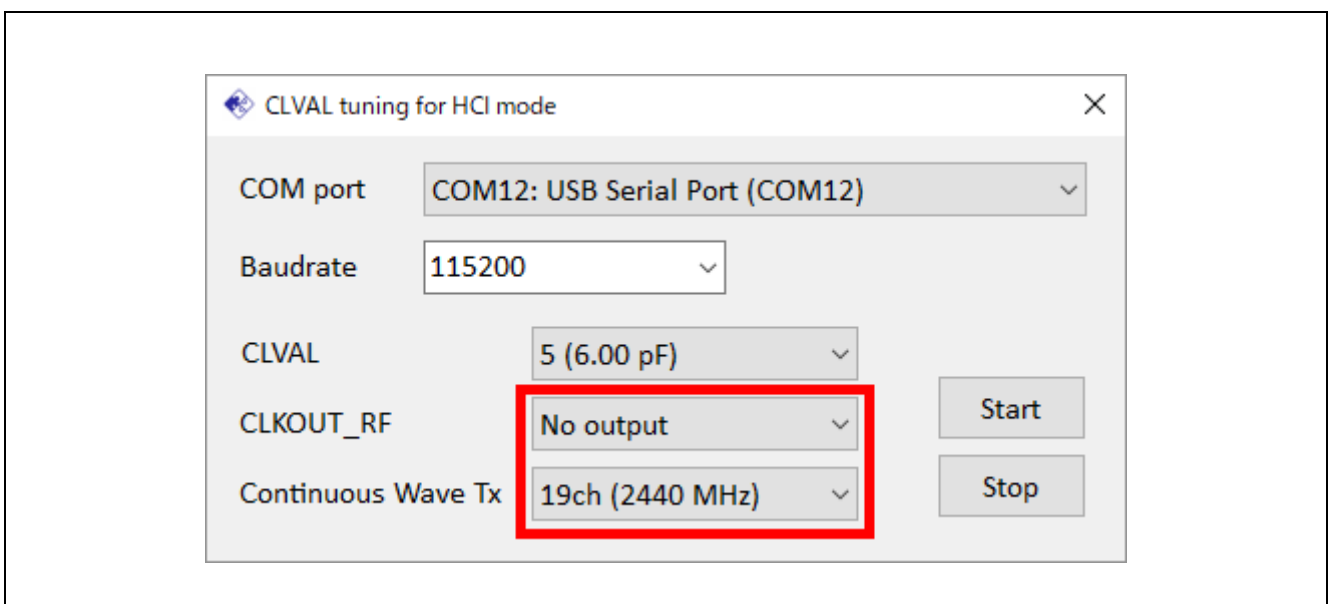


図 3-3 プログラム設定(ANT 端子で周波数観測する場合)

3.4 Bluetooth 専用クロック周波数の調整手順

下記に Bluetooth 専用クロック周波数の調整手順を示します。

手順に従い、周波数調整容量の最適設定(CLVAL)を決定して下さい。

1. 測定セットアップを構築し、スペクトラムアナライザを周波数カウントモードに設定します。
2. RE01B に周波数調整用ファームウェアをダウンロードします。
3. “CLVALTune.exe”を起動します。
4. 測定セットアップに対応したプログラム設定を行い、任意の CLVAL 設定値を選択します。
5. Start ボタンをクリックします。ANT 端子から信号が出力されます。
6. 測定器の周波数カウント表示値を記録し、Stop ボタンをクリックします。ANT 端子の信号出力が停止します。
7. 目標周波数(2440 MHz)に対し、測定周波数が低い場合は CLVAL 設定値を小さく、周波数が高い場合は CLVAL 設定値を大きく変更して下さい。
8. 周波数誤差が最小となるまで、5-7 の手順を繰り返し、最適な CLVAL 設定値を求めます。

本測定で求めた CLVAL 設定値は、アプリケーション開発時、Bluetooth Low Energy スタック Basic パッケージのコンフィギュレーションパラメータに設定しアプリケーションをビルドしてください。図 3-4 にコンフィグパラメータへの記述例を示します。

```
/**
 * @def BLE_CFG_RF_CLVAL
 * @brief Capacity adjustment of 32MHz crystal resonator.
 * @details    0 to 15: Adjust according to board environment. ¥n
 *             default : 6
 */
#define BLE_CFG_RF_CLVAL          (7)
```

図 3-4 コンフィギュレーションパラメータへの記述例

4. RF トランシーバ用水晶振動子

発振特性はボード実装によって変わるため、発振子メーカーに相談した上で、水晶振動子を選定して下さい。本章では水晶振動子を選定する際の注意事項について説明します。

- 水晶振動子は使用するアプリケーションの規格を守るように選定する必要があります。
 - 例えば、Bluetooth 5.0 規格において、初期誤差、温度ドリフト、および経時変化を含め、Bluetooth 専用クロックの精度は、 ± 50 ppm 以内と規定されています。
- RF トランシーバ用水晶振動子に推奨される要求仕様は下記となります。
 - 等価直列抵抗(ESR) ≤ 100 ohm
 - 励振電力 ≤ 100 uW
 - 負荷容量 ≤ 5 pF, ≤ 8 pF
 - 周波数トレランス $\leq \pm 30$ ppm
- ESR は要求仕様に対して小さい必要があります。要求仕様より大きい ESR の水晶振動子は発振器の負性抵抗を低下させ、予期せぬ発振停止や長い起動時間の原因となる可能性があります。
- 負荷容量の変化に対する周波数変動が小さい水晶振動子を選択すると、使用するアプリケーションの周波数精度要件のマージンを改善するのに役立ちます。負荷容量に対する周波数変動量は、水晶発振器ごとに異なります。詳細については、水晶振動子メーカーのデータシートを参照するか、メーカーにお問い合わせ下さい。
- 水晶発振器の特性はボード実装に依存します。推奨のボードパターンについては、RE01B ボードデザインガイドラインを参照下さい(R01AN5471)。
- 表 4-1 に RF トランシーバ用 32MHz 水晶振動子の候補例を示します。表の水晶振動子は例であり、一切特性を保証するものではありません。

表 4-1 RF トランシーバ用 32MHz 水晶振動子の候補例

Manufacturer	Parts number	Size code in mm	Tolerance ¹ (ppm)	MAX ESR ² (Ohm)	Load Capacitance (pF)
NDK	NX1612SA-32.000MHZ-CHP-CIS-3	1612	± 30	100	6
NDK	NX1210AB-32.000MHZ-CHP-CIX-3	1210	± 30	100	6
Kyocera	CX1612DB32000 A0WPNC1	1612	± 25	100	5
Kyocera	CX1210SB32000 B0GPJC1	1210	± 30	80	6
Murata	XRCMD32M000FZQ52R0	1612	± 30	60	6
Murata	XRCTD32M000N1P00R0	1210	± 30	120	6

- 【注】 1. Tolerance : 周波数公差 と 周波数安定性の合計値
2. MAX ESR: 最大等価直列抵抗

5. 参考

5.1 周波数調整例

表 5-1 の測定条件で ANT 出力信号周波数を有線接続で観測し、Bluetooth 専用クロックの周波数調整を実施した例を示します。

表 5-1 周波数調整の測定条件

項目	構成内容
DUT	RE01B 64pin QFN
水晶振動子	NX1612SA-32.000MHZ-CHP-CIS-3 (NDK)
測定器	E4440A PSA スペクトラムアナライザ (Keysight)
モニタ端子	ANT 有線接続

CLVAL 設定を変更したときの周波数誤差プロットを図 5-1 に示します。グラフから周波数誤差が最小となる CLVAL 設定($CLVAL_{opt}$)は 7 です。

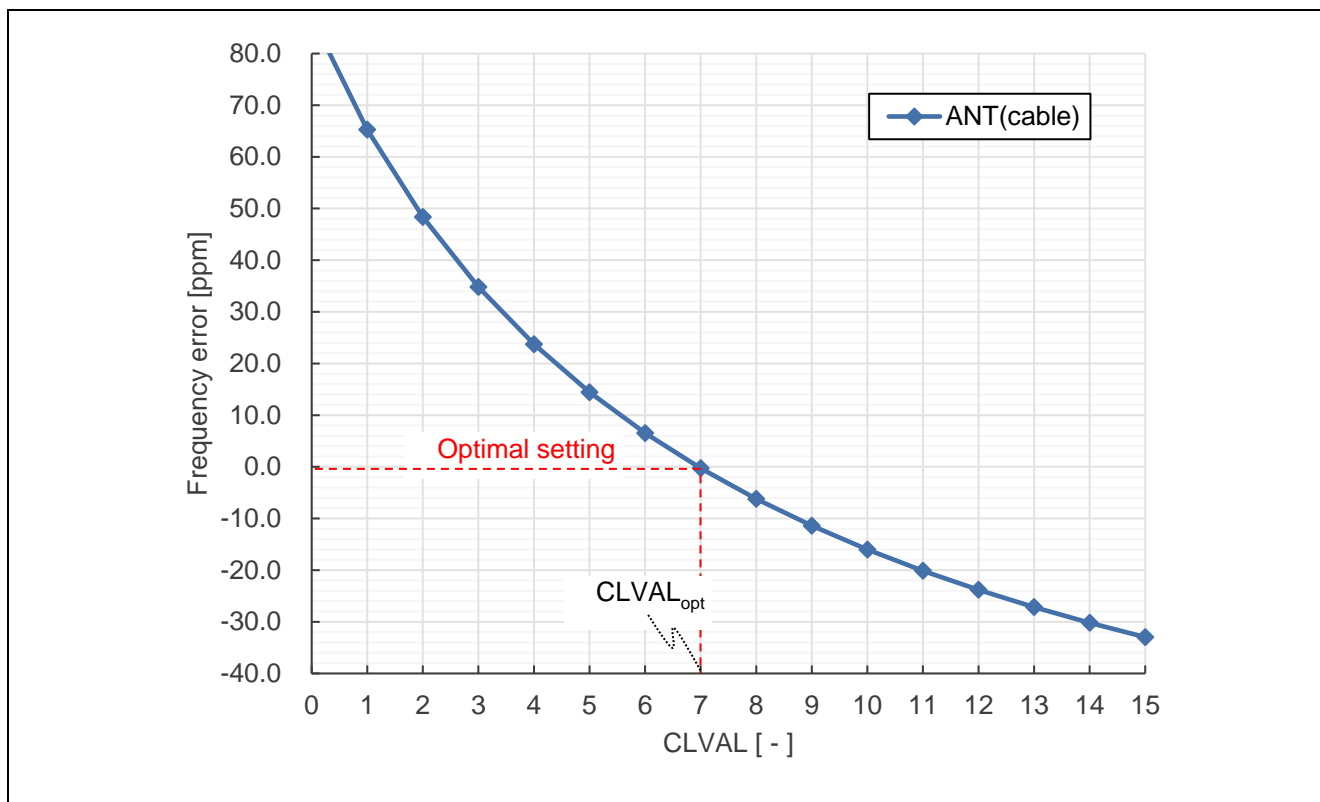


図 5-1 CLVAL 設定に対する周波数誤差

図 5-2 は本例において CLVAL 設定を $CLVAL_{opt}$ としたときの周波数カウント測定結果です。周波数カウント値は 2439.9993 MHz であり、初期調整誤差は $(2439.9993 - 2440)/2440 = -0.3$ ppm です。

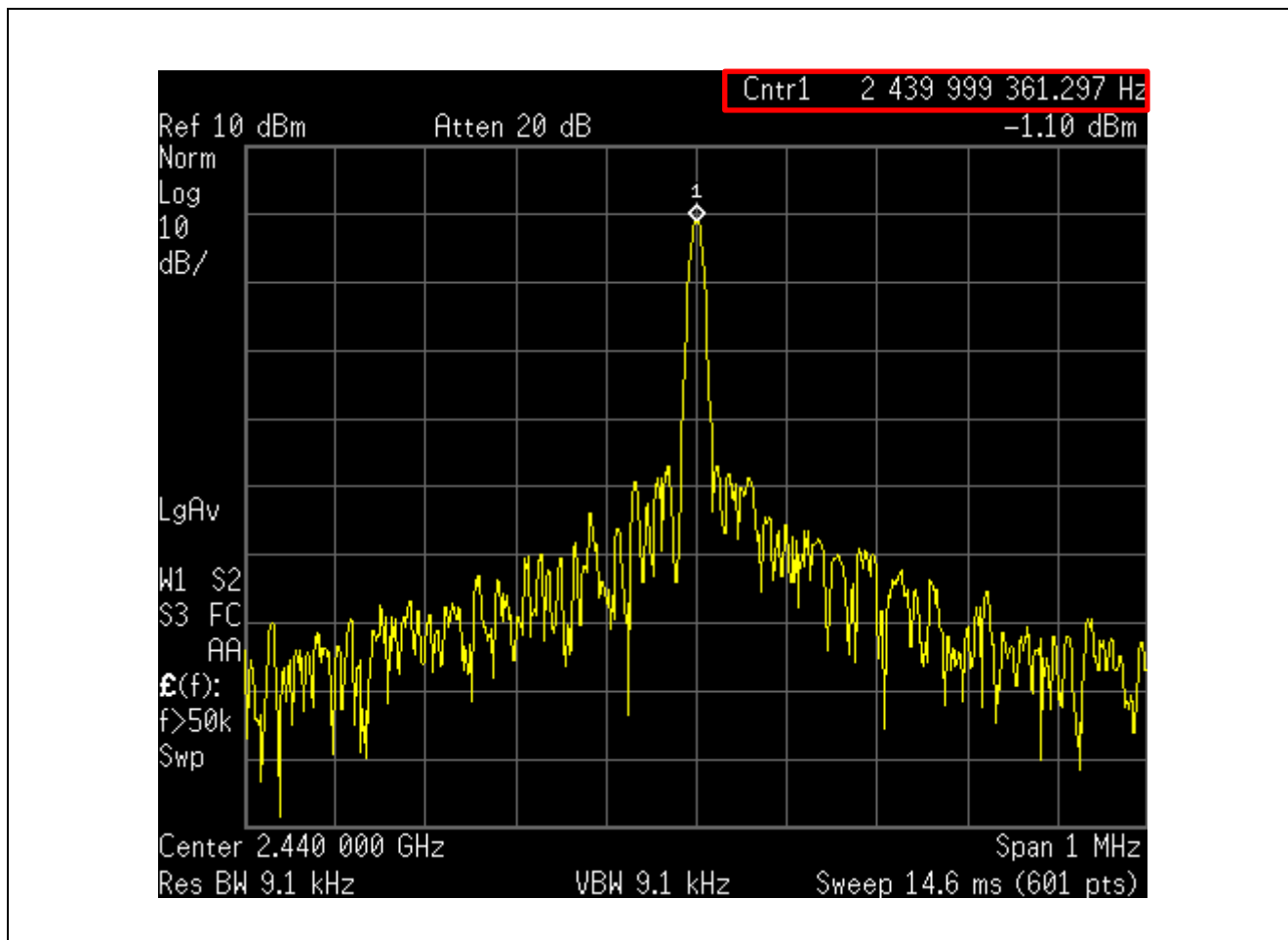


図 5-2 E4440A 周波数カウント測定結果

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Mar.25.21	—	初版発行

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れしないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違えば、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレストシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。